

博敏电子股份有限公司

关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”，公司持有其 100%股权）为公司提供连带责任保证担保，金额为人民币 5,000 万元。深圳博敏已实际为公司提供的担保余额为人民币 14,906.71 万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含全资或控股子公司）2020 年度拟向银行申请不超过 23 亿元人民币的综合授信额度。公司对全资子公司深圳博敏的担保总额不超过人民币 1.6 亿元，公司接受深圳博敏的担保总额不超过 6.5 亿元，上述额度可视需要进行互相调配，该事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、2019 年年度股东大会审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2020 年 4 月 29 日披露的公司《关于 2020 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临 2020-020）》和 2020 年 5 月 20 日披露的公司《2019 年年度股东大会决议公告（2020-033）》。

在上述授权范围内，公司因日常经营发展需要，向上海浦东发展银行股份有

限公司惠州分行申请授信额度为人民币 5,000 万元，期限为一年，由子公司深圳博敏为公司上述授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：博敏电子股份有限公司

注册地点：梅州市经济开发试验区东升工业园

法定代表人：徐缓

经营范围：研发、制造、销售：双面、多层、柔性、高频、HDI 印刷电路板等新型电子元器件；电路板表面元件贴片、封装；货物的进出口、技术进出口；投资；不动产及机器设备租赁；软件的设计、开发、技术服务和咨询；网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生产、加工、销售；电子材料的研发、生产和销售；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2019 年 12 月 31 日，博敏电子资产总额为 448,227.44 万元，负债总额为 201,619.31 万元，其中银行贷款总额为 71,033.58 万元、流动负债总额为 169,724.15 万元，净资产为 246,608.13 万元，2019 年营业收入为 266,928.81 万元，净利润为 20,155.71 万元。（以上数据经审计）

截至 2020 年 6 月 30 日，博敏电子资产总额为 476,385.69 万元，负债总额为 219,188.71 万元，其中银行贷款总额为 86,714.61 万元、流动负债总额为 170,068.99 万元，净资产为 257,196.98 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 130,309.73 万元，净利润为 12,510.30 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议主要内容

担保金额：人民币 5,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止；保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止；宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期；债权人与债务人就主债

务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后两年止。

担保范围：合同所述之主债权及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、董事会意见

董事会认为：此次担保是为满足公司在经营过程中的资金需要，公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。深圳博敏为公司子公司，其为公司提供担保不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 307,687.17 万元（除上市公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提供的担保外，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的 124.77%；公司对控股子公司提供的担保总额为 193,663.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.53%。（未经审计、不含本次担保）

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日